

股票简称:拓荆科技

股票代码:688072

拓荆科技股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书

Piotech Inc.

辽宁省沈阳市浑南区水家900号

保荐机构(主承销商)

招商证券

(深圳市福田区福田街道福华一路111号)

联席主承销商

国开证券

(北京市西城区阜成门外大街29号1-9层)

2022年4月19日

2.间接持股情况

截至本上市公告书签署日,发行人部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员通过员工持股平台间接持有公司股份,具体情况如下:

姓名	公司职务/亲属关系	间接持股的平台	间接持股股数(股)	占本次发行后股本比例	质押股数(股)	限售期限
吕光泉	董事长、核心技术人员	芯鑫龙	630,000	0.4981%	630,000	自上市之日起36个月
		沈阳盛腾	25,000	0.0198%	0	自上市之日起36个月
		芯鑫盛	883,900	0.6889%	883,900	自上市之日起36个月
		沈阳阳旺	40,000	0.0316%	0	自上市之日起36个月
		沈阳阳旺旺	60,000	0.0474%	0	自上市之日起36个月
叶五毛	监事会主席、核心技术人员	芯鑫成	330,000	0.2609%	330,000	自上市之日起36个月
		沈阳盛腾	40,000	0.0316%	0	自上市之日起36个月
		芯鑫成	111,700	0.0883%	111,700	自上市之日起36个月
		沈阳盛腾	49,000	0.0387%	0	自上市之日起36个月
		沈阳盛腾	3,000	0.0024%	0	自上市之日起36个月
田晓明	总经理、核心技术人员	芯鑫全	400,000	0.3163%	400,000	自上市之日起36个月
		沈阳盛腾	100,000	0.0791%	0	自上市之日起36个月
张孝勇	副总经理、核心技术人员	芯鑫成	765,000	0.6048%	765,000	自上市之日起36个月
		沈阳盛腾	140,000	0.1107%	0	自上市之日起36个月
周 坚	副总经理、核心技术人员	芯鑫龙	250,000	0.1977%	250,000	自上市之日起36个月
		沈阳阳旺	40,000	0.0316%	0	自上市之日起36个月
		芯鑫全	301,000	0.2380%	301,000	自上市之日起36个月
		芯鑫阳	274,386	0.2169%	274,386	自上市之日起36个月
		芯鑫龙	126	0.0001%	126	自上市之日起36个月
刘 静	副总经理、财务负责人	芯鑫和	126	0.0001%	126	自上市之日起36个月
		芯鑫和	94,000	0.0743%	0	自上市之日起36个月
		沈阳盛腾	2,900	0.0023%	0	自上市之日起36个月
		芯鑫和	363,300	0.2872%	363,300	自上市之日起36个月
		芯鑫旺	127,126	0.1006%	127,126	自上市之日起36个月
孙丽杰	副总经理	芯鑫全	126	0.0001%	126	自上市之日起36个月
		芯鑫成	125	0.0001%	125	自上市之日起36个月
		芯鑫盛	125	0.0001%	125	自上市之日起36个月
		沈阳盛腾	81,700	0.0646%	0	自上市之日起36个月
		沈阳盛龙	10,080	0.0080%	0	自上市之日起36个月
赵 曦	董事会秘书	芯鑫盛	60,000	0.0474%	60,000	自上市之日起36个月
		芯鑫龙	265,630	0.2100%	265,630	自上市之日起36个月
		沈阳盛旺	36,230	0.0286%	0	自上市之日起36个月
		沈阳盛全	17,000	0.0134%	0	自上市之日起36个月
		芯鑫盛	17,000	0.0134%	0	自上市之日起36个月

注:部分公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过芯鑫和等7个共青城员工持股平台间接持有的公司股份,存在股权质押情况,质押股数详见上表。

截至本上市公告书签署日,除前述部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员通过员工持股平台间接持有的公司股份外,部分董事因直接或间接持有发行人其他股东的股份而间接持有发行人股份,具体情况如下:①董事齐晋通过屹新(上海)企业管理有限公司(有限合伙)间接持有发行人股东上海的股份,并因此间接持有发行人约446股股份,占公司本次发行后股本比例约0.0004%;②董事尹志尧合计持有发行人股东中微公司约1.0437%的股份,并因此间接持有发行人约110,868股股份,占公司本次发行后股本比例约0.0877%。董事齐晋、尹志尧通过发行人股东国投上海、中微公司间接持有的公司股份遵循相关股东所持股份的锁定期限,具体请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”的相关内容。

本次发行后,公司部分高级管理人员和核心员工通过招商资管拓荆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有公司0.080,974股股份,占公司本次发行后股本比例2.4360%。该资产管理计划的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所之日起开始计算。招商资管拓荆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划具体情况请参见本公告“七、本次发行的战略配售安排”之“(三)发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况”相关内容。

截至本上市公告书签署日,除上述情形外,不存在其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况。

(六)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司债券的情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有公司债券的情况。

四、本次发行前已制定或实施的股权激励计划情况

截至本上市公告书签署日,公司存在上市前已经执行完毕的股权奖励。

(一)发行人员工股权激励的基本情况

发行人本次发行上市前已实施的员工股权激励中,吕光泉等七名专家直接持股并通过员工持股平台间接持股,姜谦及其余员工通过员工持股平台间接持有发行人激励股份。

1.直接并间接持有激励股份的人员情况

截至本上市公告书签署日,吕光泉等七名专家直接持有并通过员工持股平台间接持有发行人激励股份,具体情况如下:

序号	姓名	公司职务	直接持股股数(股)	通过员工持股平台间接持股股数(股)	合计持股股数(股)
1	吕光泉	现任董事长	500,000	655,000	1,155,000
2	刘汉军	曾任副总经理	290,000	140,000	430,000
3	董复华	曾任副总经理	265,000	150,000	405,000
4	吴 昊	曾任副总经理	175,000	175,000	350,000
5	周 仁	曾任副总经理	175,000	175,000	350,000
6	张宏智	现任公司顾问	160,000	345,000	505,000
7	张孝勇	现任副总经理	150,000	905,000	1,055,000
合计			1,095,000	2,545,000	4,240,000

2.员工持股平台情况

除前述七名专家直接持有并通过员工持股平台间接持有公司激励股份外,姜谦及其余员工通过发行人设立的员工持股平台间接持有公司激励股份。

截至本上市公告书签署日,发行人设有芯鑫和、芯鑫全、芯鑫龙、芯鑫成、芯鑫旺、芯鑫盛、芯鑫阳、沈阳盛腾、沈阳盛旺、沈阳盛全、沈阳盛盛等11个员工持股平台,合计持有发行人11,481,700股股份,占本次发行前股份总数的12.1040%。前述11个员工持股平台持有发行人股份情况如下:

序号	股东名称	股权取得时间	持股股数(股)	占本次发行前股本比例
1	芯鑫和	2019年12月,发行人第四次增资	1,380,996	1.4568%
2	芯鑫全	同上	1,380,546	1.4564%
3	芯鑫龙	同上	1,380,416	1.4562%
4	芯鑫成	同上	1,380,205	1.4560%
5	芯鑫旺	同上	1,380,186	1.4560%
6	芯鑫盛	同上	1,379,725	1.4545%
7	芯鑫阳	同上	1,377,926	1.4526%
8	沈阳盛腾	2014年1月,自孙丽杰受让股权	787,500	0.8302%
9	沈阳盛全	同上	237,450	0.2503%
10	沈阳盛龙	同上	168,850	0.1780%
11	沈阳盛旺	2014年1月,自孙丽杰受让股权;2015年7月,自王祥昱受让股权	627,900	0.6619%
合计			11,481,700	12.1040%

3.员工持股平台情况

除前述七名专家直接持有并通过员工持股平台间接持有公司激励股份外,姜谦及其余员工通过发行人设立的员工持股平台间接持有公司激励股份。

截至本上市公告书签署日,发行人设有芯鑫和、芯鑫全、芯鑫龙、芯鑫成、芯鑫旺、芯鑫盛、芯鑫阳、沈阳盛腾、沈阳盛旺、沈阳盛全、沈阳盛盛等11个员工持股平台,合计持有发行人11,481,700股股份,占本次发行前股份总数的12.1040%。前述11个员工持股平台持有发行人股份情况如下:

序号	出 资 人	出 资 额 (元)	享 有 的 合 伙 权 益 比 例	合 伙 人 性 质
1	孙丽杰	22,189,000	5.97%	普通合伙人
2	姜 谦	33,304,000	15.64%	有限合伙人
3	吕 欣	11,766,000	6.28%	有限合伙人
4	朱超群	11,100,000	5.92%	有限合伙人
5	徐珊珊	10,545,000	5.63%	有限合伙人
6	徐 琳	9,380,000	5.00%	有限合伙人
7	王琳琳	8,602,000	4.59%	有限合伙人
8	杨 丹	7,493,000	4.00%	有限合伙人
9	荆卿倩	7,216,000	3.85%	有限合伙人
10	张 博	6,660,000	3.55%	有限合伙人
11	张有发	6,660,000	3.55%	有限合伙人
12	张国雄	6,105,000	3.26%	有限合伙人
13	王 卓	5,273,000	2.81%	有限合伙人
14	芦 佳	5,217,000	2.78%	有限合伙人
15	陈 璇	4,955,000	2.69%	有限合伙人
16	薛 洋	4,662,000	2.49%	有限合伙人
17	国建花	4,551,000	2.43%	有限合伙人
18	陈英男	3,663,000	1.95%	有限合伙人

注:①沈阳盛盛全合伙人刘静、孙恒宇出资额中的11,000,000元、4,000,000元为合伙管理费用,根据合伙企业约定不享有合伙企业权益;②沈阳盛盛全合伙人王月,与沈阳盛盛全合伙人王月同,非同一人。

(4)沈阳盛盛全

沈阳盛盛全直接持有发行人16,886,950股股份,其基本情况如下:

序号	出 资 人	出 资 额 (元)	享 有 的 合 伙 权 益 比 例	合 伙 人 性 质
1	孙丽杰	22,189,000	5.97%	普通合伙人
2	姜 谦	33,304,000	15.64%	有限合伙人
3	吕 欣	11,766,000	6.28%	有限合伙人
4	朱超群	11,100,000	5.92%	有限合伙人
5	徐珊珊	10,545,000	5.63%	有限合伙人
6	徐 琳	9,380,000	5.00%	有限合伙人
7	王琳琳	8,602,000	4.59%	有限合伙人
8	杨 丹	7,493,000	4.00%	有限合伙人
9	荆卿倩	7,216,000	3.85%	有限合伙人
10	张 博	6,660,000	3.55%	有限合伙人
11	张有发	6,660,000	3.55%	有限合伙人
12	张国雄	6,105,000	3.26%	有限合伙人
13	王 卓	5,273,000	2.81%	有限合伙人
14	芦 佳	5,217,000	2.78%	有限合伙人
15	陈 璇	4,955,000	2.69%	有限合伙人
16	薛 洋	4,662,000	2.49%	有限合伙人
17	国建花	4,551,000	2.43%	有限合伙人
18	陈英男	3,663,000	1.95%	有限合伙人

注:①沈阳盛盛全合伙人刘静、孙恒宇出资额中的11,000,000元、4,000,000元为合伙管理费用,根据合伙企业约定不享有合伙企业权益;②沈阳盛盛全合伙人王月,与沈阳盛盛全合伙人王月同,非同一人。

(4)沈阳盛盛全

沈阳盛盛全直接持有发行人16,886,950股股份,其基本情况如下:

序号	出 资 人	出 资 额 (元)	享 有 的 合 伙 权 益 比 例	合 伙 人 性 质
1	孙丽杰	22,189,000	5.97%	普通合伙人
2	姜 谦	33,304,000	15.64%	有限合伙人
3	吕 欣	11,766,000	6.28%	有限合伙人
4	朱超群	11,100,000	5.92%	有限合伙人
5	徐珊珊	10,545,000	5.63%	有限合伙人
6	徐 琳	9,380,000	5.00%	有限合伙人
7	王琳琳	8,602,000	4.59%	有限合伙人
8	杨 丹	7,493,000	4.00%	有限合伙人
9	荆卿倩	7,216,000	3.85%	有限合伙人
10	张 博	6,660,000	3.55%	有限合伙人
11	张有发	6,660,000	3.55%	有限合伙人
12	张国雄	6,105,000	3.26%	有限合伙人
13	王 卓	5,273,000	2.81%	有限合伙人
14	芦 佳	5,217,000	2.78%	有限合伙人
15	陈 璇	4,955,000	2.69%	有限合伙人
16	薛 洋	4,662,000	2.49%	有限合伙人
17	国建花	4,551,000	2.43%	有限合伙人
18	陈英男	3,663,000	1.95%	有限合伙人

(下转A17版)

拓荆科技股份有限公司(以下简称“拓荆科技”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2022年4月20日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票

市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司

的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。本上市公告书中的报告期均指2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-9月。

本上市公告书数值通常保留至小数点后两位或后四位,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%。上交所主板新股上市首日涨幅限制44%,上市首日跌幅限制36%,次日交易日开始涨跌幅限制为10%,科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

(二)无限售流通股数量较多

上市初期,因原始股股东的股份锁定期均为12个月及以上,保荐机构限售股份锁定期为24个月,高级管理人员与核心员工参与战略配售的股份锁定期为12个月,网下限售股锁定期为6个月。本次发行后本公司的无限售流通股为26,170,753股,占发行后总股本的20.69%,较上市初期无限售流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)融资融券风险

科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅要承担担保资产的价格变化带来的风险,还承担担保资产价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券(或融券)融资、融券卖出或融券买还可能受损,产生较大的流动性风险。

(四)行业销售和同行业可比公司比较情况

发行人本次发行价格71.88元/股对应的市销率为:

(1)15.65倍(每股收入按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算);

(2)20.87倍(每股收入按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算)。

截至2022年4月1日(T-3日),公司可比A股上市公司估值水平如下:

证券简称	公司市值(亿元)	2020年营业收入(亿元)	对应静态市销率(倍)
688012.SH	722.24	22.73	31.77
688037.SH	122.10	3.29	37.12
688022.SH	377.45	10.07	37.42
平均值	407.26	12.03	36.45

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年4月1日(T-3日)。

由上表,公司2018-2019年的发行市销率低于可比A股上市公司35.45倍的静态市销率平均值。公司本次发行市销率水平低于同行业可比公司平均水平,但仍旧存在未来发行人股价

下跌给投资者带来损失的风险。

三、特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容,并应特别关注下列重要事项及风险因素:

(一)技术人员流失及无法持续引入高端技术人才的风险

公司所处的半导体专用设备行业属于技术密集型行业,涉及等离子物理、射频及微波学、微观分子动力学、结构力学、光学及能谱学、真空机械传输等多种科学技术及工程领域学科知识的有效应用,高端技术人才是企业持续发展及保持竞争力的驱动力。

近年来,国内半导体专用设备市场和晶圆制造需求不断增长,行业内企业人才竞争日益激烈,专业化人才呈现短缺趋势。报告期内,公司核心技术人员人数分别为18人、15人、22人和21人,研发人员离职率分别为13.10%、10.95%、13.02%和12.60%,存在一定的研发人员流失风险。公司若无法持续为技术人才提供较优厚的薪酬待遇和发展平台,无法持续吸引全球高端技术人才,则将面临技术人才流失、储备不足的局面,并可能导致公司创新能力不足。

(二)扣除非经常性损益后尚未盈利及持续亏损风险

报告期内,公司净利润分别为-10,322.29万元、-1,936.64万元、-1,169.99万元及5,704.87万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-14,993.05万元、-6,246.63万元、-5,711.62万元和-2,305.21万元。报告期内,公司扣除非经常性损益后尚未实现盈利,主要由于半导体设备行业技术含量高,研发投入大,产品验证周期长,公司

需要持续进行了大量的研发投入。报告期内,公司研发投入费用分别为10,797.31万元、7,431.87万元、12,278.18万元和12,965.63万元,占各期营业收入的比例为152.84%、295.8%、281.9%和34.65%。研发费用金额较大和占营业收入的比例较高,是公司亏损主要原因。

报告期内,公司扣除非经常性损益后的亏损额已逐年收窄,但如果未来发生市场竞争加剧、宏观经济和半导体产业景气度下行、主要客户削减资本支出预算、公司大幅增加研发投入或公司不能有效拓展新客户等情况,将使公司面临一定的经营压力,公司未来一定期间内仍存在无法实现扣除非经常性损益后盈利的风险。

(三)产品验证周期较长风险

晶圆制造属于高精精密制造领域,对产线上各环节的良率要求极高,任何进入量产线的设备均需经过长时间工艺验证和产线联调测试。特别是对于薄膜沉积设备而言,由于薄膜是芯片结构的功能材料层,在芯片完成制造、封测等工序后会留存芯片中,薄膜的技术参数直接影响芯片性能。生产中不仅需要在前膜后检测薄膜厚度、均匀性、光学参数、机械应力及颗粒度等性能指标,还需要在完成晶圆生产流程及芯片封装后,对最终芯片产品进行可靠性和生命周期测试,以衡量薄膜沉积设备是否最终满足技术标准。因此,晶圆厂对薄膜沉积设备所需要的验证时间相比其他半导体专用设备可能更长。

对于新客户的台订单或新工艺订单设备,一般从新客户需求沟通、方案设计、样机制造、场工艺测试与调试到客户端样机安装调试、工艺验证到最后的工艺验证和产品验收通过,整个流程可能需要6-24个月甚至更长时间。对于重复订单设备,由于已通过客户工艺验证,新订单设备的工艺验证一般无重大改动,从出货到设备验收通常需3-24个月的时间。如设备验收周期时间波动主要系受到客户产线设备、客户端安装调试、客户工艺要求调整、客户验收流程限制以及其他偶然性因素的影响。

如果受某些因素影响,公司产品验收周期延长,公司的收入确认将有所延迟。另外,可能存在公司设备验收不通过、收款时间延后等风险,增加公司的资金压力,影响公司的财务状况。

(四)收入依赖PCVD系列产品,ALD